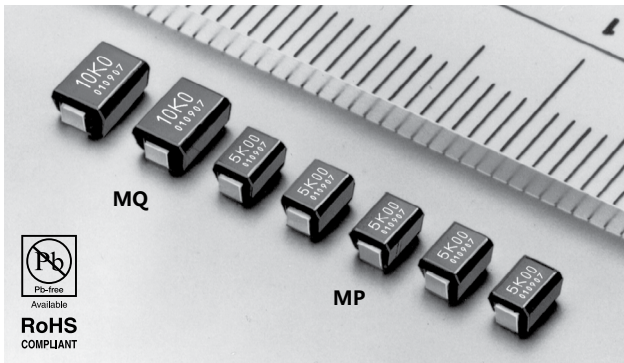


超精密表面贴装电阻 (模压, 型引脚)



温度系数, 阻值范围, 精度, 额定功率				
系列号	温度系数 (ppm/°C) -55°C ~ +125°C	阻值范围 (Ω)	阻值精度 (%)	额定功率 (W) 125°C
MP	0±10	30~100	±0.1	0.1
	0±5	100~30k	±0.05	
MQ	0±10	30~100	±0.1	0.125
	0±5	100~60K	±0.05	

* 更高精度请联系我们

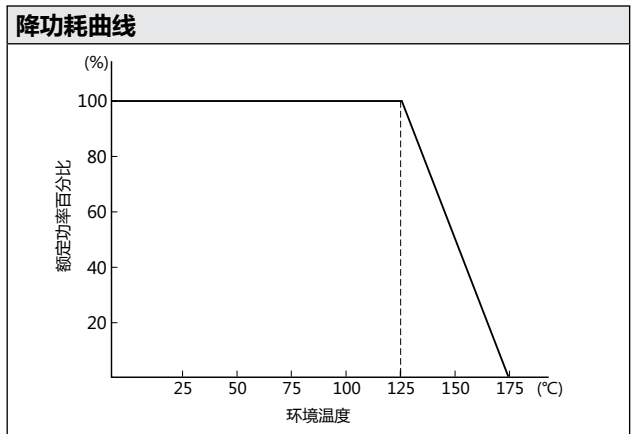
选型表

选型举例:

MQ 10K00 L

—— 编带包装可选
—— 阻值
—— 系列号

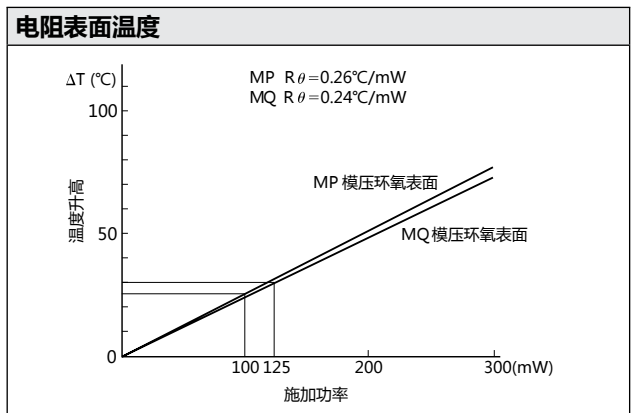
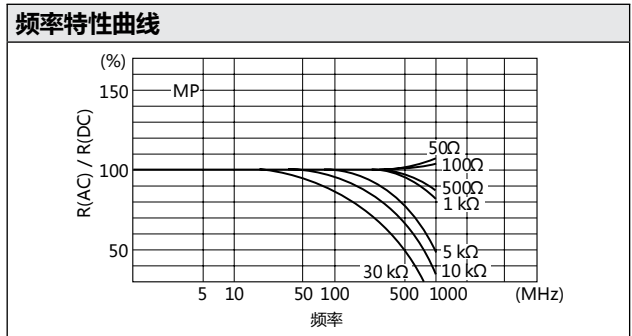
用5位代码表示阻值, 4位有效数字。R或K表示阻值范围 (R代表欧姆, K代表千欧姆)和小数点的位置。



结构图

系列	MP	MQ
L	3.2±0.2	4.5±0.2
W	2.5±0.2	3.2±0.2
H	2.0±0.2	
L1	0.6±0.2	0.8±0.2
W ₁	1.4±0.3	
W ₂	2.3±0.2	3.0±0.2
H ₁	1.5±0.3	
t	0.15±0.05	

尺寸单位(mm)



性能		测试条件	ALPHA 测试参数	ALPHA 典型值
最大额定工作温度 工作温度范围 最大工作电压 最大工作电流			125°C -65°C ~ +175°C MP=50V, MQ=100V 350mA	
热冲击 过载	-65°C/30 min. ↔ +175°C/30 min., 5次循环 额定电压 x 2.5, 5 sec.		±0.05% ±0.05%	±0.01% ±0.01%
低温存储和工作 基板弯曲测试	-65°C, 无负载, 24 hrs. → 额定电压, 45 min. 基板弯曲 3 mm, 60 sec.		±0.05% ±0.05%	±0.01% ±0.01%
绝缘电压 绝缘电阻 焊接特性 耐湿性	大气压下: AC 200V, 1 min. DC 100V, 1 min. 260°C, 10 sec. +65°C ~ -10°C, 90% RH ~ 98% RH, 额定电压, 10次循环 (240 hrs.)		±0.01% 大于10,000M Ω ±0.05% ±0.05%	±0.005% 大于10,000M Ω ±0.01% ±0.03%
冲击振动, 高频	100G, 6 ms, 锯齿波, X, Y, Z, 各10次循环 20G, 10 Hz ~ 2,000 Hz ~ 10 Hz, 20 min., X, Y, Z, 各2.5 hrs.		±0.02% ±0.02%	±0.01% ±0.01%
寿命	125°C, 额定功率, 1.5 hr. - ON, 0.5 hr. - OFF, 2,000 hrs.		±0.05%	±0.03%
存储寿命	15°C ~ 35°C, 15% RH ~ 75% RH, 无负载, 10,000 hrs.		±0.005%	±0.0025%
高温暴露	175°C, 无负载, 2,000 hrs.		±0.05%	±0.03%

编带包装 (基于EIA-481-1)																		
编带尺寸										包装盘尺寸								
系列	A	B	C	D	E	F	G	H	J	A	N	B	C	D	W ₁	W ₂	r	
MP	2.8 ±0.2	3.9 ±0.2	12.0 ±0.3	5.5 ±0.05	1.75 ±0.1	4.0 ±0.1	2.0 ±0.05	4.0 ±0.1	φ1.5 ±0.1-0	φ178 ±2	φ60 min	φ13 ±0.5	φ21 ±0.8	2 ±0.5	12.4 +2.0-0	18.4 max	1.0 ±0.5	
MQ	3.6 ±0.2	5.2 ±0.2	12.0 ±0.3	5.5 ±0.05	1.75 ±0.1	8.0 ±0.1	2.0 ±0.05	4.0 ±0.1	φ1.5 ±0.1-0	编带容量: MP: 1200pcs/盘		MQ: 800pcs/盘						
尺寸单位(mm)																		

使用表面倒装贴片电阻注意事项																			
<p>1. 存储 存储条件或环境可能对电阻引脚的可焊性产生影响。不可存储于高温和高湿环境。建议存储于温度低于40°C, 湿度低于70%RH的环境, 避免接触硫磺气体和含氯气体等。</p>		<p>3. 清洁 使用挥发性清洁剂比如甲醇或者异丙醇。</p>																	
<p>2. 焊接注意事项 ① 手工焊接—适用的手工焊接如右图所示 建议 • 烙铁温度: 240°C ~ 270°C • 烙铁功率: 20W 或更低 • 烙铁尖端直径: 3 mm max.</p>		<p>4. 电路板设计 焊接面积取决于电阻尺寸和焊接方法, 也受贴装设备和基板材料的影响, 如下图。</p>																	
<p>② 回流焊接 建议 • 最高温度: 250 + 0 / - 5°C • 高温时间: 10 sec. max. • 室温下冷却</p>																			
<p>③ 浸焊 (波峰或静止) 建议 • 焊接温度: 260°C max. • 浸入时间长: 10 sec. • 室温下冷却</p>																			
<p>④ 其他 推荐无腐蚀焊剂, 比如松脂。焊接后, 不可立即给模压外壳施加应力。</p>																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>系列</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MP</td> <td>1.6 ~ 2.0</td> <td>0.5 ~ 1.5</td> <td>2.2 ~ 2.6</td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>MQ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.5</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">尺寸单位(mm)</p>			系列	A	B	C	D	MP	1.6 ~ 2.0	0.5 ~ 1.5	2.2 ~ 2.6	1.8	MQ				2.5
系列	A	B	C	D															
MP	1.6 ~ 2.0	0.5 ~ 1.5	2.2 ~ 2.6	1.8															
MQ				2.5															
<p>当电阻在电路板高密度的安装时, 一定量的焊膏可能接触到电阻, 影响了电阻的性能或者可靠性。为避免这种影响, 建议焊接电阻时隔离焊盘区域。</p>																			